

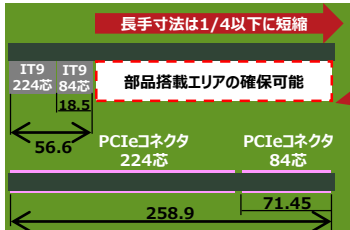
特長

- 1 高速伝送対応(28+Gbps対応)
- 2 高密度 : 50差動ペア/インチ (224芯)
- 3 フローティング構造により同一基板に複数実装可能
- 4 バリエーション
・芯数 : 84芯、152芯、224芯

PCI Express
4.0/5.0対応

高密度実装

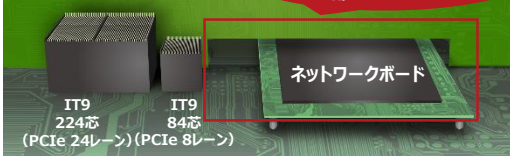
カードエッジコネクタとの実装面積比較



高密度実装のため、長手寸法は1/4以下に短縮。部品搭載可能エリアが増加

ご使用例

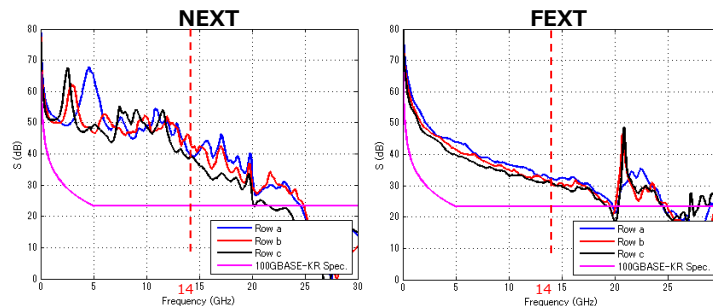
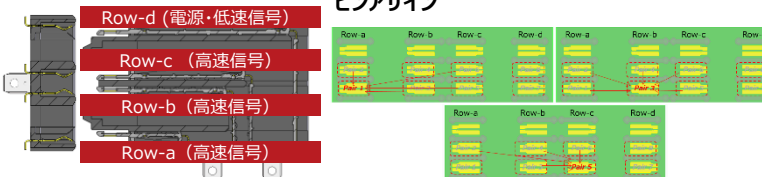
オプションボード



長手寸法の短縮により、オプションボード下に他部品を搭載可能

28+Gbps対応/SI特性

ピンアサイン



仕様

| | |
|----------|--|
| 定格電流 | 0.3A (差動信号ブレード) 0.5A (電源/低速信号ブレード) |
| 定格電圧 | 50V AC/DC |
| 使用温度範囲*1 | -55 to +85°C |
| 接触抵抗*2 | Row-a : 60mΩ以下 Row-b : 70mΩ以下 Row-c : 80mΩ以下 Row-d : 90mΩ以下 |
| 耐電圧 | 150V ACで1分間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ 以上 (100V DC) |
| 挿抜回数 | 100回 |

*1 通電による温度上昇を含む
*2 導体抵抗を含む

IEEE802.3apの規格において、十分なマージンを有しております